

国泰海通证券股份有限公司

关于广州安凯微电子股份有限公司

2026 年持续督导半年度跟踪报告

保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：安凯微
保荐代表人姓名：周成材、吴熠昊	被保荐公司代码：688620

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）批复，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票 9,800.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.68 元，募集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 92,495.90 万元。本次发行证券已于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）担任其持续督导保荐人，持续督导期间为 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日。

在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2026 年上半年持续督导情况报告如下：

一、2026 年上半年保荐人持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐人已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。

项 目	工作内容
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐人已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐人已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐人已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐人已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐人已督促上市公司实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐人、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐人、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐人和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	上市公司无控股股东。本持续督导期间，上市公司及实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐人已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐人已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或	上市公司无控股股东。本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。

项 目	工作内容
者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上交所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐人及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露现场核查报告。	
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐人、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件； （二）资产被查封、扣押或冻结； （三）未能清偿到期债务； （四）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项； （六）交易所或者保荐人认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐人、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化； （二）核心技术人员离职； （三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷； （四）主要产品研发失败； （五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者； （六）交易所或者保荐人认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，公司原核心技术人员于茂先生因达到法定退休年龄，且与公司劳动合同期满后不再续签，双方的劳动合同关系已依法终止，于茂先生不再担任公司任何职务。经核查，保荐人认为：公司核心技术人员基本保持稳定、研发团队结构完整，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，此次核心技术人员的变动不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。 除上述情况外，本持续督导期间，上市公司不存在所述的其他重大风险。
14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐人、保荐代表人应当就相	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）所持上市公司股份被司法冻结； （二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的； （三）上交所或者保荐人认为应当发表意见的其他情形。	
15、督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	上市公司无控股股东。保荐人已督促实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐人对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于 2026 年 8 月 11 日-2026 年 8 月 12 日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查。
17、保荐人发表核查意见情况。	2026 年上半年，保荐人发表核查意见具体情况如下： 2026 年 3 月 18 日，保荐人发表《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》； 2026 年 4 月 23 日，保荐人发表《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》； 2026 年 4 月 23 日，保荐人发表《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》； 2026 年 4 月 23 日，保荐人发表《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2026 年度申请综合授信额度暨关联担保的核查意见》； 2026 年 4 月 30 日，保荐人发表《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告》； 2026 年 5 月 20 日，保荐人发表《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》；

项 目	工作内容
	2026 年 6 月 19 日，保荐人发表《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。
18、保荐人发现的问题及整改情况（如有）	无

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代及新产品开发风险

集成电路设计行业属于典型的智力密集型行业，工艺、设计技术的升级以及产品的更新换代相对较快。公司主要从事赋能 AI 硬件的 AI SoC 芯片的研发设计。

随着人工智能技术的发展和渗透，市场对于端侧和边缘侧 AI SoC 芯片的功耗、性能、边缘计算能力、无线连接能力、兼容性等要求不断提高。公司必须根据不同类别芯片的市场需求变动和技术水平发展对现有技术进行升级迭代，以保持技术和产品的竞争力。

研发过程中，如果公司无法持续提升研发能力、无法根据终端市场需求不断开发、推出新的产品系列、无法在更高端的应用产品领域实现技术突破，则可能使公司在日益激烈的市场竞争环境中处于劣势地位，从而会对公司市场份额和核心竞争力产生不利影响。

此外，技术升级迭代及新产品开发需要持续大量的资金投入。报告期内，公司研发投入费用为 9,355.48 万元，占当期收入比例为 21.47%，较去年同期增加 2,613.18 万元，同比增 38.76%。如果公司未来技术研发的投入不足，不能支撑技术升级迭代及新产品开发的需要，如果投入无法转化为研发成果或者研发成

果不能达到预期效果，可能导致公司产品被竞争对手产品替代或者淘汰，进而对公司的持续竞争力产生不利影响。

2、技术实力与国际领先企业相比存在差距的风险

在面向 AI 硬件的 AI SoC 芯片领域，公司与国际领先的芯片设计公司相比，在研发实力和产品技术水平等方面具有一定差距。

以物联网摄像机芯片为例，覆盖同类产品的头部国际企业已经推出采用先进工艺制程的芯片。公司目前计划采用 12nm 工艺制程的芯片产品在研中，时间进度与行业头部企业仍存在一定差距。

未来，若公司研发未能突破更先进的芯片工艺制程或者采用其他替代性的技术路径，弥补与国际领先企业在研发能力与技术实力方面的差距，及时提升产品的市场竞争力，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。

3、其他常见的技术风险

公司所处芯片设计行业为典型的技术密集型行业，面临核心技术人员流失或不足、技术泄密等高科技企业普遍面临的技术风险。

AI SoC 芯片对技术人员专业程度、经验水平均有较高的要求。近年来在国家政策的大力支持下，半导体企业数量高速增长，行业优秀技术人才的争夺激烈。若公司核心技术人员离职，或大量优秀的技术研发人才集中离职，而公司无法在短期内引进经验丰富的人才，则将对公司技术创新及芯片研发造成不利影响，从而影响公司的持续竞争力。

核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，公司重视对核心技术的保护工作，制定了严格的信息安全保护制度，以确保核心技术的保密性。若公司相关保密和内控制度无法有效运行，或者因核心技术保密不善或被外部窃取而导致泄密，将对公司的核心竞争力带来负面影响。

（二）经营风险

1、市场竞争风险及成长性风险

目前，端侧 AI 和边缘智能芯片领域的国内外竞争对手较多，同时不断有新企业进入该行业，市场竞争激烈。

与同行业头部企业相比，公司在产品布局、市场地位、收入规模和盈利能力方面仍然存在一定差距。同时，报告期内公司物联网摄像机芯片销售收入占比较大，且物联网摄像机芯片的新兴应用以及物联网应用处理器芯片等新产品或新的细分市场拓展都还在持续推进中，未来能否顺利拓展存在不确定性。

公司需要持续投入大量资金用于核心技术及新产品的研发，保持自身市场竞争力并努力缩小与行业内头部企业的差距。若公司无法把握市场需求与行业发展趋势，不能根据终端市场需求进行产品布局、推出新产品，则可能导致公司竞争力下降。若公司无法有效推出合适的芯片产品，公司未来的发展空间将受到限制，公司的行业地位、市场份额、核心竞争力、成长性等可能受到不利影响。

2、原材料持续涨价风险

近年来，全球半导体产业链面临原材料成本持续上涨、晶圆代工、封装测试及存储芯片等关键环节/成本价格上行的普遍压力。公司采用 Fabless 经营模式，生产制造高度依赖第三方代工厂，上游原材料与封测成本直接构成营业成本的主要组成部分，成本波动对盈利能力影响显著。若未来原材料价格攀升或产能供应趋紧，公司可能面临采购成本上升、毛利率下滑的压力；与此同时，终端市场竞争加剧，下游客户对价格敏感度较高，存在成本压力难以完全向下游传导的风险。存储芯片产能趋紧、价格上涨，存在显著影响产品成本及供应能力不足的风险。面对成本端刚性上升、原材料产能紧缺、市场端议价能力受限等多重挑战，若公司未能有效应对，可能面临盈利能力下降、市场份额受损的风险，对经营业绩和发展产生不利影响。

3、客户集中及变动风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入集中度相对较高。公司产品包括物联网摄像机芯片、应用处理器芯片及蓝牙芯片，产品下游应用领域主要集中在智能家居、智慧安防、智能穿戴领域，目标客户群体较为明确，客户集中度较高，若主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求大幅下降或调整采购政策，均可能导致公司销售订单减少，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

虽然公司主要客户能够与公司持续发生交易，但如果部分客户经营不善或发生不利变化，或者公司无法维持、发展与现有客户的合作关系，则公司将面临客户流失和销售困难的风险，从而对公司经营业绩产生影响。

4、供应商集中和委托外部加工生产风险

公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，从事芯片的研发、设计、终测和销售，而将晶圆生产、芯片封装等生产环节外包给相关企业。晶圆制造、芯片封装对于技术水平和企业经营规模都具有较高的门槛，集中度较高。公司与主要供应商建立了良好、稳定的合作关系。若上游供应商工艺发生变更或发生不可抗力的突发事件，可能导致公司需要切换新的代工厂或重新进行新工艺磨合，需要消耗较长时间和较高的成本；此外，若因集成电路市场需求旺盛、偶发性供应不足等因素而出现产能紧张情形，或供应商生产环节出现质量问题，或其他不可抗因素引起的产能供给问题，将影响公司的生产计划和产品的交付，最终均会对公司的经营业绩产生不利影响。

5、公司产品结构相对集中的风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自于物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片和蓝牙芯片。总体来看产品线相对集中，应用领域还需进一步拓宽。由于新产品研究开发、市场推广的整体周期相对较长，如果未来公司现有产品的市场需求发生较大波动或公司无法及时响应市场对新技术、新功能的需求，新产品无法顺利推出，则将对公司经营带来不利影响。

6、业务区域集中风险

报告期内，出口占公司当期主营业务收入的比例相对较高。如果公司出口销售出现重大不利情况，或者公司未来在国内市场的开拓受阻，可能对公司未来业务发展造成不利影响。

7、规模扩张导致的管理、内控体系建设及内控制度执行风险

随着公司业务的进一步发展和募集资金投资项目的开展实施，上市后公司的业务和资产规模将进一步提升，对公司在治理结构设计、战略规划、市场拓展、人才队伍建设等多方面提出了更高的要求。如果公司的管理能力和管理体系不能

满足规模扩大所提出的要求,将使公司在一定程度上面临规模扩张导致的管理风险、内控体系建设及内控制度执行风险。

8、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金投资项目为物联网领域芯片研发升级及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目,项目的制定结合了国家产业政策、行业发展现状和未来发展趋势,并经过了充分、谨慎的可行性研究论证。募投项目的有效管理和组织实施是项目成功与否的关键,虽然公司对募集资金投资项目进行了可行性论证,但募投项目经济效益相关的分析数据均为预测性信息,且项目建设尚需较长时间,存在一定募投项目实施及效益未达预期的风险。

随着集成电路行业的快速发展,若募投项目在实施过程中宏观经济形势、市场环境、产业政策发生重大不利变化,或芯片研发遇到技术瓶颈、产品迭代不如预期、募投产品的客户导入进展较慢等情形,将导致公司募集资金投资项目不能按期完成或者无法实现预期经济效益,公司则面临可能无法按既定计划实现预期收益的风险。

9、并购风险

公司收购思澈科技控股权涉及资金压力与商誉减值风险。公司需通过中长期贷款筹措交易价款,将提升财务杠杆并增加未来利息支出;同时,交易形成大额商誉,且标的公司目前处于亏损状态,若未来经营未达预期,可能计提商誉减值并对当期损益造成不利影响。

业务整合与市场竞争层面亦存在不确定性。双方在技术、市场及供应链的深度整合中,若协同效应不及预期或核心团队出现流失,可能影响战略目标实现。此外,标的公司所处 AIoT 赛道竞争激烈,下游需求受消费电子周期影响较大,若业绩承诺未能实现,将对本次并购的战略价值构成挑战。

(三) 财务风险

1、经营业绩波动风险

若公司所处下游行业景气度下滑,消费电子市场需求低迷、市场竞争愈发激烈,导致公司现有产品的销售价格和毛利率下降;或上游产能紧张,产品成本

上升；以及公司无法快速准确地适应市场需求的变化，新产品市场开拓不及预期，客户开拓不利或重要客户合作关系发生变化等不确定因素使公司市场竞争力发生变化，导致公司产品出现售价下降、成本上升、销售量降低等不利情形，将对公司业绩增长带来一定不确定性，未来经营业绩将面临波动风险。

2、材料成本大幅上升风险

原材料与封测成本是公司营业成本的主要组成部分。近年来，全球半导体产业链面临原材料成本持续上涨的普遍压力，如存储颗粒产能趋紧、价格上涨，存在显著影响产品成本及供应能力不足的风险。若未来原材料价格持续攀升或产能供应持续趋紧，公司可能面临采购成本上升、产能不足、毛利率下滑的压力；与此同时，终端市场竞争加剧，下游客户对价格敏感度较高，存在成本压力难以完全向下游传导的风险。面对成本端刚性上升、原材料产能紧缺、市场端议价能力受限等多重挑战，若公司未能有效应对，可能对经营业绩和发展产生不利影响。

3、应收账款发生坏账的风险

公司处于开拓发展阶段，给予主要经销商和部分重点客户一定账期。公司采用预期信用损失模型对应收账款计提坏账准备，报告期末，公司应收账款坏账准备的计提为 5.64%，未来若某些客户因经营情况发生不利变化导致公司无法及时回收货款或形成坏账，公司将面临应收账款坏账损失金额增加的风险。

4、存货跌价风险

公司根据在手订单、客户预计需求、上游晶圆制造和封装测试的产能以及公司的库存情况制定采购计划。截至报告期末，公司存货主要为公司芯片以及对应的晶圆和配套封装芯片。

鉴于芯片生产需要一定的周期，公司需要准备一定的库存，以及时满足客户的采购需求。若公司产品的市场需求发生变化、竞争加剧、技术更新加快导致公司产品价格下降或者存货滞销积压，从而导致公司存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

5、新增资产折旧、摊销费用导致净资产收益率及每股收益下滑风险

本次物联网领域芯片研发升级及产业化项目总投资额为 55,385.90 万元，建设期 48 个月；本次研发中心建设项目总投资额为 22,110.00 万元，建设期 60 个月。公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，投资金额较大，随着募集资金投资项目实施，公司将新增较大金额的固定资产和无形资产，相应导致每年新增较大金额的折旧及摊销费用。

如未来竞争环境和行业发展出现重大不利变化，募投项目未实现预期收益，且项目收益未能覆盖相关费用，则公司存在因新增的折旧摊销费用较大而导致公司净资产收益率及每股收益下滑、影响公司经营业绩的风险。

（四）行业风险

1、第三方技术授权风险

公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，专注于芯片的研发、设计、终测和销售。在芯片研发过程中，公司所使用的 EDA 工具主要向 EDA 供应商采购。目前国内 EDA 市场仍主要由国外优势厂商占据主要市场份额。公司短期内仍需要向国际 EDA 优势厂商采购 EDA 工具。

此外，随着集成电路产业不断发展，产业链分工逐渐细致化，芯片设计企业通过购买 IP 授权，可加快产品研发进度，缩短研发周期。公司在芯片研发过程中亦向第三方 IP 授权方采购了 CPU、MIPI、USB 等部分第三方 IP。

若公司在 EDA 工具或 IP 授权协议到期后，因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素，无法与其中部分授权商继续签订授权协议或取得授权成本大幅增加，且公司无法在合理期限内自行开发或找到其他授权商，则会对公司正常生产经营产生不利影响。

2、晶圆供货短缺引起的募投等项目产能不足风险

公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，晶圆主要通过晶圆制造商进行代工。近年来晶圆代工市场景气度的变化较快，行业内芯片设计厂商存在晶圆供货短缺、晶圆制造产能不足的风险，对芯片设计企业的产能造成影响。

若未来晶圆代工厂因芯片市场需求旺盛或者其他原因出现供应商产能供给紧张、产能排期紧张，或发生重大自然灾害等突发事件、业务经营发生不利变化，

导致产能无法满足募投等项目晶圆采购需求，或者不能提供生产代工服务等情形，可能导致公司面临募投等项目产能不足的风险。

（五）宏观环境风险

近年来国际贸易环境的不确定性增加，贸易摩擦不断加剧，部分国家采取激进的贸易保护措施。集成电路行业具有典型的全球化分工合作的特点，短期内，宏观环境及政策风险对公司发展和产品市场的拓展影响有限，但若国际贸易环境进一步恶化、各国贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对公司所处的集成电路产业链产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加或者交易阻碍，从而可能对公司的经营带来负面影响。

四、重大违规事项

2026 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，公司主要财务数据如下：

单位：万元

主要会计数据	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	43,579.44	23,430.71	85.99
利润总额	3,756.24	-4,944.37	不适用
归属于上市公司股东的 净利润	4,026.67	-4,925.07	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	3,985.25	-4,932.77	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	2,319.64	-5,657.51	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的 净资产	131,269.83	129,192.16	1.61
总资产	208,471.25	163,833.68	27.25

2026 年 1-6 月，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.13	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.08	-3.48	增加 6.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.05	-3.49	增加 6.54 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	21.47	28.78	减少 7.31 个百分点

1、报告期内，公司实现营业收入 43,579.44 万元，较去年同期增加 20,148.74 万元，同比上升 85.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,026.67 万元，同比增加 8,951.74 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,985.25 万元，同比增加 8,918.02 万元；基本每股收益和稀释每股收益为 0.10 元/股，同比增加 0.23 元/股；加权平均净资产收益率同比增加 6.56 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加 6.54 个百分点；研发投入占营业收入的比例同比下降 7.31 个百分点。

2、报告期内，受益于市场需求持续增长及已推出产品逐步顺利导入市场，公司芯片产品的出货量实现了增长；同时，公司为应对存储等上游原材料、封装成本上涨影响，上调了产品销售价格，公司 2026 年半年度营业收入及净利润实现大幅度增长；主要在以上因素的综合影响下，公司的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈。

3、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益扭亏为盈，主要系本期归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈所致。

4、报告期内，研发费用较上年同期增加 2,613.18 万元，增长 38.76%，研发投入占营业收入的比例同比下降 7.31 个百分点，主要系由于收入金额增长影响研发投入占营业收入的比例同比下降。

5、经营活动产生的现金流量净额 2,319.64 万元，同比增加 7,977.15 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度高于购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金的增长幅度所致。

六、核心竞争力的变化情况

报告期内，公司围绕 AI 硬件核心 SoC 芯片领域持续进行研发投入。公司基于“芯片+算法+方案”，逐步构建端侧 AI 和边缘推理相关技术能力，在底层技术、产品矩阵、应用场景及人才建设等方面形成了相应的竞争优势。报告期内，公司各项核心业务稳步推进。

1、坚持底层技术自主研发，积累核心 IP 与专利资产

公司坚持核心技术自主可控，经过多年研发，形成了覆盖 SoC 架构、机器学习、ISP（图像信号处理）、音视频图像图形、短距离通信及低功耗设计等领域的多项核心 IP。目前，公司芯片中约 75% 的 IP 为自主研发，相关 IP 已在多代产品中进行量产验证，具备较好的成熟度。依托平台化研发体系，公司实现了核心 IP 的复用与迭代，以响应端侧设备对集成度与功耗的要求。在低功耗设计方面，公司 KM01 系列芯片在 AOV 模式下整机功耗可控制在 30mW 以内，该产品获得第二十届“中国芯”优秀市场表现产品奖。报告期内，公司搭载 AI 算力的芯片出货占比保持增长趋势，AI 算力在公司产品线中的普及率进一步提升。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计拥有境内外授权专利 429 个、计算机软件著作权 94 个、集成电路布图设计 29 个及注册商标 121 个（含境外商标 5 个）。

2、推进“芯片+算法+方案”协同，完善系统级 AI 应用解决方案能力

构建和完善端侧 AI 及边缘推理相关技术体系：

硬件与算力层面：智能视觉、低功耗蓝牙、智能交互、电源管理等多产品协同，覆盖视觉采集、无线连接及本地推理等硬件需求。产品持续向更高算力方向规划和演进，旨在满足端侧 AI、边缘推理更广泛的市场需求。

算法与模型层面：公司与国内部分 AI 大模型及算法企业开展技术合作，结合自研的应用算法模型和场景定制中小模型，通过软硬件协同优化，提升边缘侧的推理效率。

开发工具层面：为客户提供配套的 PDK 开发包、HDK 硬件开发套件及 SDK 软件工具链，降低客户的二次开发门槛。

端云协同层面：公司相关芯片方案已适配主流云端大模型 API，支持终端设备调用云端算力，构建端云协同的处理机制。

3、拓展 AI 智能穿戴等应用场景，抓住新兴 AI 硬件爆发的机会

在现有技术体系基础上，公司将 AI 智能穿戴（如 AI 眼镜）作为重点拓展的应用场景之一，是国内为数不多的基于视觉 SoC 芯片提供 AI 眼镜配套解决方案并实现量产的企业之一。目前，公司方案可应用于 AI 拍照/摄像眼镜、AI 音频眼镜及 AI 显示/投影眼镜等品类：智能视觉芯片（如 KM 系列/AK39 系列）负责视觉处理，低功耗蓝牙芯片（如 AK1080/AK1090）负责无线连接，以满足不同终端的硬件需求。同时，公司新一代 AI 眼镜 SoC 芯片正在研发中，该芯片采用多核异构架构并集成 NPU，算力与影像处理性能较前代产品有所提升，支持本地轻量化部署多模态模型，可实现实时翻译、智能识图及语音交互等功能。报告期内，公司 AI 眼镜相关芯片方案已实现批量交付，并向 AI 音频眼镜、AI 显示眼镜等应用持续推广。公司依托技术和市场积累在 AI 智能穿戴等新兴 AI 硬件领域积累了一定的市场先发优势，有助于抓住市场爆发契机，以实现更多的增长点。

4、丰富产品矩阵，构建产业协同生态

公司通过内部研发与外部合作，不断完善产品矩阵与产业链协同。

完善产品矩阵：公司已形成“视觉+音频+图形+连接+交互”的产品矩阵，并匹配算力、算法能力和低功耗优势，提升了一站式解决方案的优势和完整度。

构建协同生态：公司搭建了“端-边-云”协同架构，满足下游多样化智能化处理需求，以提升解决方案的优势和客户黏性。

5、完善研发体系与激励机制，保障技术团队稳定性

研发平台建设：公司设有博士后科研工作站分站及省级研发平台，并建立了内部技术传帮带机制与畅通的技术上升通道，以维持核心技术团队的稳定性。

长效激励机制：公司运用股权激励工具绑定核心人才。前期实施的限制性股票激励计划覆盖了公司董事、高管及核心技术骨干，考核指标涵盖公司业绩、部

门贡献与个人绩效；同时，公司推出新一期股份回购计划用于员工持股或股权激励。相关机制的建立和措施的落实有助于保障公司技术研发的持续性。

综上所述，公司以自主研发的底层技术为基础，以“芯片+算法+方案”的综合优势为依托，持续拓展新兴的 AI 硬件应用场景，并配合产业生态整合与人才激励机制，形成了从芯片设计到场景落地的业务闭环机制和能力，为公司把握端侧 AI 和边缘推理发展机遇提供了基础支撑。

2026 年上半年，未发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事件。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司研发费用较上年同期增加 2,613.18 万元，增长 38.76%，研发投入占营业收入的比例同比下降 7.31 个百分点，主要系由于收入金额增长影响研发投入占营业收入的比例同比下降。

经过多年自主创新，公司在 SoC 架构、机器学习、ISP、音视频图像处理、短距离通讯及超低功耗等领域沉淀了多项核心 IP，多项关键技术指标达到行业领先水平。其中，自研 NPU 自 2021 年首次流片验证以来持续迭代，已在全线多颗芯片中实现量产；NPU 算力正式从产品的“可选配件”迈向“标准配置”阶段。同时，公司在 RISC-V 技术领域取得显著突破，形成覆盖视觉处理、音频交互、智能物联等关键领域的产品矩阵，并于 2026 年 1 月荣获 IC 风云榜“年度 RISC-V 技术创新奖”。此外，通过收购思澈科技，公司进一步增强了低功耗无线通信与图形显示技术能力，在蓝牙芯片领域形成“音频+连接+图形+低功耗”的技术融合，全面夯实了公司在 AIoT 领域的综合技术底座。

依托扎实的核心技术，公司已构建了完整的“端-边-云”协同闭环体系：端侧推动全产品线集成轻量级 AI 预处理，实现人形检测、语音识别等实时响应；边缘侧与算法伙伴深度协同，开发基于大语言/大视觉模型的本地化中小模型，并进一步规划和强化芯片的边缘推理能力；云端全面适配主流大模型 API，持续增强“端侧采集-边缘计算-云端赋能”的软硬件技术闭环。在前瞻研发方面，公司依托专业覆盖面广的研发团队与成熟的量产流程，继续保持高强度研发投入。报告期内，面向高算力与高性能图像处理需求的 12nm 制程芯片正按计划推进流

片工作；基于边缘智能处理需求的兴起，公司计划立项更高算力、能支持一定参数模型的芯片，面向边缘智能盒子、机器人等应用，持续拓展端侧智能化与边缘推理的应用边界。

公司高度重视知识产权的创造、运用与保护，技术壁垒持续加固。2026 年 2 月，公司成功入选国家知识产权局“2025—2027 年国家知识产权强国建设示范创建对象”名单，标志着公司知识产权综合实力迈入国家级示范行列。报告期内，公司新增国内外授权专利 13 个、计算机软件著作权 2 个、集成电路布图设计 2 个及国内外商标 8 个。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计拥有境内外授权专利 429 个、计算机软件著作权 94 个、集成电路布图设计 29 个及注册商标 121 个（含境外商标 5 个）。此外，公司持续加码 AI 前沿技术的专利布局，截至报告期末，累计提交申请人工智能、机器学习相关境内外专利 30 个，完成相关计算机软件著作权登记 9 个。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	104,664.00
减：发行费用	12,168.10
募集资金净额	92,495.90
减：募集资金置换和项目投入金额	48,347.15
其中：以前年度募集资金置换和项目投入金额	42,706.96
报告期内募集资金置换和项目投入金额	5,640.19
减：现金管理	43,000.00
其中：以前年度现金管理	48,000.00
报告期内现金管理赎回金额	-5,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	81.49
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	80.54

项目	金额
报告期内利息收入扣除手续费净额	0.95
加：理财收入	1,390.74
其中：以前年度理财收入	1,040.75
报告期内理财收入	349.99
募集资金专户余额	2,620.98

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司无控股股东，本持续督导期间，公司实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员持有的公司股份未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐人提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、定期报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2026 年持续督导半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



周成材



吴熠昊

